

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏艾森半导体材料股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：艾森股份
保荐代表人姓名：刘伟	联系电话：021-38966588
保荐代表人姓名：张帅	联系电话：021-38966588

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，对艾森股份进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、市场竞争风险

随着下游封测厂商持续加大投入先进封装技术，先进封装用电子化学品面临着良好的发展机遇。公司推出了多款先进封装用光刻胶及配套试剂产品。先进封装领域具有较好的市场前景，其他内资厂商持续增加研发投入、扩建产能或推出新产品参与市场竞争。如公司未能持续更新技术及开发产品，降低产品成本，则公司将面临不断加大竞争压力，并降低公司光刻胶配套试剂的收入增速或市场份额。下游封测厂商对光刻胶的可靠性和稳定性要求极高，更换供应商难度较大。公司与国际巨头争夺高端市场，公司面临无法抢占其市场份额的竞争风险。综上，

如果公司不能根据市场需求持续更新技术和开发产品，保持产品和技术竞争力，公司可能无法与国内外企业进行有效竞争，从而对公司的市场份额、市场地位、经营业绩造成不利影响。

2、自研产品产业化风险

公司自研的光刻胶产品及用于晶圆制造先进制程的电镀液系列产品，虽均已通过行业主要客户的认证并进入正式供货阶段，但尚未能实现对下游客户竞品的完全替代，处于产业化前期，对收入贡献较低。由于下游客户对产品性能、品质及稳定性要求严格，相关产品认证时间及量产周期均较长，且影响因素众多，如受产品稳定性不足、客户推迟上线安排、下游市场需求变动等因素影响，公司自研产品无法实现大规模产业化，将对公司未来发展带来不利影响。

(二) 经营风险

1、毛利率下降的风险

公司产品包括电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大类，不同类别产品的毛利率水平主要受所处行业情况、市场供求关系、产品技术特点、产品更新迭代、公司销售及市场策略、原材料价格等因素综合影响而有所差异。若原材料价格出现回升，或公司未能根据市场变化及时进行产品技术升级，产品技术缺乏先进性，公司市场推广未达预期，造成高毛利产品销售占比下降，可能导致公司毛利率水平下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

2、原材料价格波动的风险

公司原材料主要包括各种溶剂类和固体类的化工原料，以及以锡材（锭）为主的金属材料；上述材料作为大宗工业原材料，其价格易受国际原油价格或国际金属价格的波动影响。

(三) 行业风险

1、半导体行业周期变化风险

半导体行业具有显著的周期性特征，通常经历繁荣、衰退、复苏、萧条四个阶段，周期波动与全球经济环境、下游终端需求、产能扩张节奏及库存水平高度

相关。当前行业虽处于复苏通道，但未来仍面临需求波动风险：若全球经济增速放缓、AI算力需求不及预期，或消费电子、汽车电子等下游市场再度疲软，将直接导致半导体产品需求下滑，进而影响公司光刻胶、电镀液等核心材料的订单量与产品价格。此外，行业周期性波动还可能引发客户资本开支缩减，延缓国产替代项目推进节奏，对公司业绩增长造成不利影响。

三、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年度，公司主要财务数据及指标如下表所示：

单位：万元

主要财务数据	2025年度/2025年12月31日	2024年度/2024年12月31日	增减幅度
营业收入	59,264.37	43,218.84	37.13%
归属于上市公司股东的净利润	5,123.78	3,347.75	53.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,700.36	2,439.14	92.71%
经营活动产生的现金流量净额	8,107.80	-2,471.86	不适用
归属于上市公司股东的净资产	102,986.82	97,397.15	5.74%
总资产	139,098.22	124,410.57	11.81%
主要财务指标	2025年度	2024年度	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.59	0.38	55.26%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.38	55.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.54	0.28	92.86%
加权平均净资产收益率（%）	5.13	3.29	增加 1.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.70	2.39	增加 2.31 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.71	10.62	增加 1.09 个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

1、2025年度，公司实现营业收入59,264.37万元，同比增长37.13%，其中电镀液及配套试剂同比增长46.75%，光刻胶及配套试剂同比增长43.54%。报告期内，公司锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道，在半导体封装领域实现对国外供应商的规模化替代，稳固国内市场的核心主力供应商地位，在先进封装和晶圆制造领域的市场开拓也取得成效，营业收入实现稳健增长。

2、2025年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,700.36万元，同比增长92.71%，主要原因系：（1）2025年度，公司营业收入保持稳健增长；（2）2025年度，公司先进制程电镀产品及先进封装光刻胶产品持续放量，产品结构得到优化，同时生产效率持续提升。

3、2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,123.78万元，同比增长53.05%，增长幅度低于扣除非经常性损益的净利润的增长幅度，主要系报告期内理财收益及计入当期损益的政府补助同比减少导致。

4、2025年度，公司经营活动产生的现金流量净额为8,107.80万元，经营活动产生的现金流量净额较上年度大幅改善，主要原因系公司增加票据付款，提高资金管理效率所致。

5、2025年末，公司归属于上市公司股东的净资产同比增长5.74%，总资产同比增长11.81%，保持小幅增长。

五、核心竞争力的变化情况

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。

在电镀液及配套试剂领域，经过十几年的技术沉淀与经验积累，公司凭借关键核心技术，产品性能整体已与国际竞争对手相当，部分指标甚至超越国外竞品。目前，公司电镀液产品已构建起丰富且极具竞争力的产品矩阵，在传统封装和先进封装领域均实现了全品类覆盖，并成功实现高端应用领域的市场突破。

先进封装领域，公司前瞻性布局先进封装全工艺链条，构建起覆盖硅通孔（TSV）、再布线层（RDL）、微凸点（Bumping）等核心工艺的完整产品矩阵。目前，高纯硫酸铜基液已实现先进封装头部客户的稳定供应，另有多项前沿产品已进入商业化关键阶段：电镀锡银添加剂（包括超低 α 粒子的锡浓缩液、锡阳极）小批量稳定量产，并在多家头部客户同步验证中；电镀铜添加剂处于关键批次稳定性验证阶段；TSV电镀添加剂在客户端测试验证中。

晶圆制造领域，公司大马士革电镀铜添加剂覆盖7-55nm全制程节点，确保铜互连具有优异的填充能力与低缺陷率，可满足不同客户的工艺需求；针对5-14nm节点对互连阻抗和可靠性的更高要求，公司钴制程电镀液提供优异的电迁移耐受性与界面稳定性。目前公司28nm大马士革铜互连工艺镀铜添加剂，5-14nm钴制程电镀基液已在主流晶圆客户端小批量量产中，同步在头部存储客户端验证顺利；适应不同深宽比孔型的TSV工艺高速镀铜添加剂也在客户端验证中。

在光刻胶及配套试剂方面，公司以光刻胶配套试剂为切入点，成功实现附着力促进剂、显影液、去除剂、蚀刻液等产品在下游封装厂商的规模化供应。同时，公司积极开展光刻胶的研发，以先进封装负性光刻胶、OLED阵列制造用光刻胶以及晶圆用PSPI等特色工艺光刻胶为突破口，覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等应用领域，成功打破国外垄断，并逐步向先进制程延伸。

先进封装领域，公司凭借技术与客户资源优势，已构建起极具竞争力的光刻胶产品矩阵，涵盖可应用于GHI-line、I-line光源的光刻胶产品，包括正性、化学放大型光刻胶及负性光刻胶，不同产品膜厚兼容7-300 μm ，在Bumping、RDL、TSV、fine pitch RDL、 $\mu\text{Bumping}$ 、 μPad 、Mega Bumping等先进封装核心工艺环节，正稳步构建光刻胶全场景产业化覆盖能力。同时，公司正加速推进用于Bumping、WLCSP、2.5D/3D封装的PSPI的验证与量产，产品包括高温固化、低温固化、超低温固化系列，其中低温PSPI在客户端小批量量产中，具备低应力、高可靠性及高分辨率的PSPI产品在客户端验证中。公司目标成为国内先进封装光刻胶和PSPI领域的主力供应商，全面提升国产光刻材料的市场渗透率。

晶圆制造领域，具有化学放大效能的I-Line光刻胶系列产品及可应用于功率

器件的PSPI已实现小批量供货，并同步在多家头部客户，包括存储芯片厂商推广验证中。高深宽比KrF光刻胶（深宽比达13:1）目前在客户端验证阶段，在高厚膜下，通过优化树脂和PAG，提升分辨率，相应提高光刻胶深宽比，主要应用在CIS芯片、存储芯片中，力求填补国内空白。

综上，2025年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

半导体行业属于典型的技术密集型产业，技术创新与产品升级换代速度极快。公司始终紧跟前沿科技发展趋势，全力推进国产化产业链建设，围绕自身核心技术，基于产业发展动态及下游客户的多样化需求，在不断提升技术与产品能力的同时积极拓宽产品品类，致力于为客户提供更具竞争力的产品组合及整体解决方案。报告期内，公司技术成果转化能力和产品开发效率显著提高，新产品开发能力和技术竞争实力持续增强。

2025年度，公司研发投入6,942.21万元，同比增长51.24%；研发投入占营业收入的比例为11.71%，同比增加1.09个百分点，公司持续加大在先进封装及晶圆制造领域的研发投入。

2025年度，公司各项在研项目均有序推进，部分项目取得阶段性成果，新增申请发明专利18项，新获授权发明专利15项，研发成果持续得到体现。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为28.03

元/股。本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金使用及结余情况如下表：

单位：万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023 年 12 月 1 日			
本报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日			
	项目	金额		
一、募集资金总额		61,759.44		
	其中：超募资金金额	-		
	减：直接支付发行费用	7,309.73		
二、募集资金净额		54,449.71		
减：				
	以前年度已使用金额	39,435.63		
	本年度使用金额	4,331.29		
	现金管理金额	-		
	银行手续费支出及汇兑损益	0.17		
加：				
	募集资金利息收入及现金管理收益	906.90		
三、报告期期末募集资金余额		11,589.52		

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 12 月 1 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态

江苏艾森 半导体材 料股份有 限公司	交通银行股份有限公司昆山 分行	391064700013000424409	1,651.72	使用中
	苏州银行股份有限公司昆山 分行	51433700001579	5,062.24	使用中
	昆山农村商业银行中华园支 行	2010020247364	4,875.56	使用中
	宁波银行苏州高新技术产业 开发区支行	75050122000714459	-	已注销
合计		/	11,589.52	/

注：截至 2025 年 12 月 31 日，江苏艾森半导体材料股份有限公司账号为 51433700001579 的募集资金专户活期存款存在 5,000.00 万元冻结资金。冻结原因系公司于 2025 年 12 月 29 日与苏州银行股份有限公司昆山支行签署《苏州银行结构性存款协议书》购买产品名称为 2025 年第 990 期定制结构性存款 3,000.00 万元及产品名称为 2025 年第 987 期定制结构性存款 2,000.00 万元。根据产品说明书及结构性存款协议书规定，银行经办机构确认公司的结构性存款购买申请后将认购资金做冻结处理。上述结构性存款认购日期为 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1 月 3 日，故于 2025 年 12 月 31 日结构性存款本金处于冻结状态。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“集成电路材料测试中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

集成电路测试中心大楼已完工并投入使用，公司已顺利完成多个产品测试平台的仪器配套与调试工作，使用情况良好。对于剩余部分仪器设备，由于涉及较多类型的精密设备及仪器，相关设备投资金额大，设备安装与调试周期长，且部分进口设备受到国际贸易摩擦和关税壁垒等外部因素的影响，公司将结合产品的研发测试进展，进行同步规划与动态部署，调整后项目实施期限延长至 2027 年 12 月。

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质

押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人的持股情况

截至本报告签署日，张兵直接持有上市公司 21.59%的股份，为上市公司控股股东；张兵、蔡卡敦分别直接持有公司 21.59%和 7.77%的股份，张兵作为执行事务合伙人通过艾森投资间接控制公司 6.66%的股份。张兵、蔡卡敦夫妇持有及控制公司合计 36.02%的股份，为公司实际控制人。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份不存在增减变动、质押、冻结及其他减持的情形。

（二）董事、监事和高级管理人员的持股情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员直接持有公司的股份情况如下：

序号	姓名	职务/身份	直接持股 (股)	年度内股份增 减变动量(股)	增减变动原因
1	张兵	董事长	19,031,621	-	/
2	陈小华	董事、常务副总经理、 董事会秘书	885,997	352,400	间接持股转为直接持股
3	杨一伍	董事	679,328	-210,000	个人资金需求减持股份
4	赵建龙	副总经理	472,530	-150,000	个人资金需求减持股份
5	谢立洋	副总经理	286,300	286,300	间接持股转为直接持股
	合计		2,135.5776	-	-

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有的公司股份不存在质押、冻结及其他减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至2025年12月31日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：


刘 伟


张 帅

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 5 月 15 日

